

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

18.11.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2002年11月18日

出 願 番 号
Application Number: 特願2002-334072
[ST. 10/C]: [JP2002-334072]

出 願 人
Applicant(s): 浜松ホトニクス株式会社

RECEIVED

09 JAN 2004

WIPO

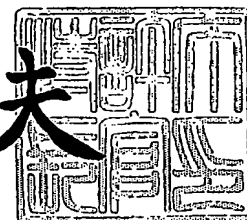
PCT

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年12月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2003-3104992

【書類名】 特許願

【整理番号】 2002-0745

【提出日】 平成14年11月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01T 1/20

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内

【氏名】 鈴木 保博

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会社内

【氏名】 水野 誠一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000236436

【氏名又は名称】 浜松ホトニクス株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088155

【弁理士】

【氏名又は名称】 長谷川 芳樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100089978

【弁理士】

【氏名又は名称】 塩田 辰也

【選任した代理人】

【識別番号】 100092657

【弁理士】

【氏名又は名称】 寺崎 史朗

【選任した代理人】

【識別番号】 100110582

【弁理士】

【氏名又は名称】 柴田 昌聰

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014708

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光検出装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入射光強度に応じた量の電荷を各々発生する N 個 (N は 2 以上の整数) のフォトダイオードと、

前記 N 個のフォトダイオードそれぞれに対応して設けられ、各々に対応するフォトダイオードに第 1 端が接続され、この第 1 端と第 2 端との間が電氣的に開閉が可能である N 個のスイッチと、

前記 N 個のスイッチそれぞれの第 2 端に共通に接続された共通配線と、

前記共通配線に入力端が接続され、この入力端より入力した電荷を蓄積して、この蓄積した電荷の量に応じた電圧値を出力端より出力する積分回路と、

を備え、

第 1 基板に前記 N 個のフォトダイオードが設けられ、

第 2 基板に前記 N 個のスイッチ、前記共通配線および前記積分回路が設けられ

、
前記第 1 基板と前記第 2 基板とが互いにバンプ接続されていて、前記フォトダイオードと前記スイッチの第 1 端とが互いに電氣的に接続されており、

前記第 2 基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、前記 N 個のスイッチ、前記共通配線および前記積分回路が設けられている、

ことを特徴とする光検出装置。

【請求項 2】 前記第 2 基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層であって、前記ボンディングパッドが設けられた領域内に、前記 N 個のスイッチ、前記共通配線および前記積分回路が設けられている、ことを特徴とする請求項 1 記載の光検出装置。

【請求項 3】 前記 N 個のフォトダイオードそれぞれから前記積分回路の入力端へ至るまでの電荷移動経路に沿った距離のうちの最大距離が最小となる位置において、前記共通配線に前記積分回路の入力端が接続されている、ことを特徴とする請求項 1 記載の光検出装置。

【請求項 4】 前記第 1 基板における前記 N 個のフォトダイオードの配置のピッチより、前記第 1 基板と前記第 2 基板との間のバンプ接続におけるバンプの配置のピッチが短い、ことを特徴とする請求項 1 記載の光検出装置。

【請求項 5】 前記 N 個のフォトダイオード、前記 N 個のスイッチ、前記共通配線および前記積分回路を 1 組として、これらを M 組 (M は 2 以上の整数) 備え、

これら M 組それぞれについて、

第 1 基板に前記 N 個のフォトダイオードが設けられ、

第 2 基板に前記 N 個のスイッチ、前記共通配線および前記積分回路が設けられ

、
前記第 1 基板と前記第 2 基板とが互いにバンプ接続されていて、前記フォトダイオードと前記スイッチの第 1 端とが互いに電氣的に接続されており、

前記第 2 基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、前記 N 個のスイッチ、前記共通配線および前記積分回路が設けられている、

ことを特徴とする請求項 1 記載の光検出装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、配列された複数のフォトダイオードを含む光検出装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

光検出装置は、1 次元状または 2 次元状に配列された複数のフォトダイオードと、アンプおよび容量素子を含む積分回路とを備えた装置であり、また、さらに以降の信号処理回路をも備える場合がある。この光検出装置では、各フォトダイオードへの入射光の強度に応じた量の電荷が該フォトダイオードから出力され、その電荷が容量素子に蓄積され、その蓄積された電荷の量に応じた電圧値が積分回路より出力される。複数のフォトダイオードそれぞれで発生した電荷の量に応

じて積分回路より出力される電圧値に基づいて、複数のフォトダイオードが配列された受光面へ入射する光が検出される。

【0 0 0 3】

このような光検出装置として特許文献 1 に開示されたものが知られている。この特許文献 1 に開示された光検出装置では、複数のフォトダイオードに対して 1 つの積分回路が設けられ、また、各フォトダイオードと積分回路の入力端との間にスイッチが設けられている。また、この光検出装置では、第 1 基板上に複数のフォトダイオードが形成され、第 2 基板上に積分回路が形成されており、第 1 基板の端部と第 2 基板の端部とがワイヤボンディングで接続されている。そして、複数のスイッチそれぞれが順次に閉じることにより、第 1 基板上の複数のフォトダイオードそれぞれで発生した電荷が順次に第 2 基板上の積分回路に入力して、その電荷の量に応じた電圧値が順次に積分回路の出力端より出力される。この光検出装置は、画素数の増加や高密度化が可能である。

【0 0 0 4】

【特許文献 1】

特開 2 0 0 1 - 2 4 2 2 5 3 号公報

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記の従来の光検出装置では、各フォトダイオードから積分回路の入力端へ至るまでの電荷移動の為の配線の経路は、第 1 基板上における各フォトダイオードから端部へ至るまでの配線経路と、第 1 基板の端部から第 2 基板の端部へ至るまでのボンディングワイヤと、第 2 基板上における端部から積分回路の入力端へ至るまでの配線経路と、を含むものとなっている。このように配線が長いと、この配線における寄生容量が大きい。それ故、上記の従来の光検出装置では、積分回路から出力される電圧値に含まれる雑音が大きく、正確な光検出をすることができない。

【0 0 0 6】

本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、画素数の増加や高密度化が可能であって正確な光検出をすることができる光検出装置を提供するこ

とを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明に係る光検出装置は、(1) 入射光強度に応じた量の電荷を各々発生する N 個 (N は 2 以上の整数) のフォトダイオードと、(2) N 個のフォトダイオードそれぞれに対応して設けられ、各々に対応するフォトダイオードに第 1 端が接続され、この第 1 端と第 2 端との間が電氣的に開閉が可能である N 個のスイッチと、(3) N 個のスイッチそれぞれの第 2 端に共通に接続された共通配線と、(4) 共通配線に入力端が接続され、この入力端より入力した電荷を蓄積して、この蓄積した電荷の量に応じた電圧値を出力端より出力する積分回路と、を備えることを特徴とする。さらに、本発明に係る光検出装置は、(a) 第 1 基板に N 個のフォトダイオードが設けられ、(b) 第 2 基板に N 個のスイッチ、共通配線および積分回路が設けられ、(c) 第 1 基板と第 2 基板とが互いにバンプ接続されていて、フォトダイオードとスイッチの第 1 端とが互いに電氣的に接続されており、(d) 第 2 基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、 N 個のスイッチ、共通配線および積分回路が設けられている、ことを特徴とする。

【0008】

本発明に係る光検出装置では、 N 個のスイッチそれぞれが順次に閉じ、これにより、 N 個のフォトダイオードそれぞれから順次に、そのフォトダイオードへの入射光の強度に応じた量の電荷が出力され、その電荷は、フォトダイオードが設けられた第 1 基板からバンプ接続を経て第 2 基板へ移動し、第 2 基板上のスイッチおよび共通配線を経て積分回路の入力端に入力する。そして、第 2 基板上の積分回路の出力端より、フォトダイオードで発生した電荷の量に応じた電圧値が出力される。このようにして、この光検出装置は、 N 個のフォトダイオードが配列されている第 1 基板に入射した光を検出することができる。

【0009】

また、この光検出装置では、フォトダイオードが設けられた第 1 基板と、共通配線および積分回路などが設けられた第 2 基板とは、互いにバンプ接続されてい

る。さらに、第2基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、共通配線および積分回路などが設けられている。このような構成としたことにより、本発明に係る光検出装置では、各フォトダイオードから積分回路の入力端へ至るまでの電荷移動経路が短くなって、その経路上の配線における寄生容量が小さくなり、それ故、積分回路から出力される電圧値に含まれる雑音が小さく、正確な光検出をすることが可能となる。また、第1基板上には積分回路などの信号処理の為の回路が設けられていないので、画素数の増加や高密度化が可能である。

【0010】

本発明に係る光検出装置は、第2基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層であって、ボンディングパッドが設けられた領域内に、N個のスイッチ、共通配線および積分回路が設けられているのが好適である。また、本発明に係る光検出装置は、N個のフォトダイオードそれぞれから積分回路の入力端へ至るまでの電荷移動経路に沿った距離のうちの最大距離が最小となる位置において、共通配線に積分回路の入力端が接続されているのが好適である。これら何れの場合にも、電荷移動経路の更なる短縮、寄生容量の更なる低減、および、積分回路からの出力電圧値に含まれる雑音の更なる低減、が可能となる。

【0011】

本発明に係る光検出装置は、第1基板におけるN個のフォトダイオードの配置のピッチより、第1基板と第2基板との間のバンプ接続におけるバンプの配置のピッチが短いのが好適である。この場合にも、電荷移動経路の更なる短縮、寄生容量の更なる低減、および、積分回路からの出力電圧値に含まれる雑音の更なる低減、が可能となる。また、第1基板より第2基板を小さくすることが容易となり、複数の光検出装置を配列する際に、フォトダイオードが設けられている各々の第1基板を極めて接近させて又は接触させて配列することができる。

【0012】

本発明に係る光検出装置は、N個のフォトダイオード、N個のスイッチ、共通配線および積分回路を1組として、これらをM組（Mは2以上の整数）備え、さ

らに、これらM組それぞれについて、(a) 第1基板にN個のフォトダイオードが設けられ、(b) 第2基板にN個のスイッチ、共通配線および積分回路が設けられ、(c) 第1基板と第2基板とが互いにバンプ接続されていて、フォトダイオードとスイッチの第1端とが互いに電氣的に接続されており、(d) 第2基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、N個のスイッチ、共通配線および積分回路が設けられているのが好適である。この場合には、第1基板上にM×N個のフォトダイオードが配列されていて、画素数の更なる増加が可能となる。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。

【0014】

まず、本実施形態に係る光検出装置1の回路構成について、図1～図3を用いて説明する。

【0015】

図1は、本実施形態に係る光検出装置1の構成図である。この図に示される光検出装置1は、M組のユニット $U_1 \sim U_M$ を備えている。各ユニット U_m は、互いに同様の構成を有しており、N個のフォトダイオード $PD_{m,1} \sim PD_{m,N}$ 、N個のスイッチ $SW_{m,1} \sim SW_{m,N}$ 、1個の積分回路 10_m 、1個のCDS (Correlated Double Sampling、相関二重サンプリング) 回路 20_m および 1個のサンプルアンドホールド回路 (以下「ホールド回路」と言う。) 30_m を備えている。ここで、Mは1以上の整数であり、Nは2以上の整数であり、mは1以上M以下の各整数であり、また、以下に現れるnは1以上N以下の各整数である。

【0016】

各フォトダイオード $PD_{m,n}$ は、入射光強度に応じた量の電荷を発生するものである。スイッチ $SW_{m,n}$ は、フォトダイオード $PD_{m,n}$ に対応して設けられており、その第1端が該フォトダイオード $PD_{m,n}$ に接続されており、その第2端が共通配線 50_m に接続されている。スイッチ $SW_{m,n}$ は、第1端と第2端との間が

電氣的に開閉が可能である。共通配線 50_mは、ユニット U_mに含まれる N 個のスイッチ SW_{m,1}～SW_{m,N}それぞれの第 2 端に共通に接続されている。

【0017】

積分回路 10_mは、共通配線 50_mに入力端が接続され、この入力端より入力した電荷を容量素子に蓄積して、この容量素子に蓄積されている電荷の量に応じた電圧値を出力端より出力する。CDS 回路 20_mは、積分回路 10_mより出力された電圧値を入力し、その入力した電圧値の一定時間の変動分を表す電圧値を出力する。ホールド回路 30_mは、CDS 回路 20_mより出力された電圧値を入力し、その電圧値を一定期間に亘って保持し出力する。

【0018】

図 2 は、本実施形態に係る光検出装置 1 に含まれる積分回路 10_mの回路図である。この図に示される積分回路 10_mは、共通配線 50_mに接続された入力端と出力端との間に並列にアンプ A、容量素子 C およびスイッチ SW を有している。スイッチ SW が閉じることにより、容量素子 C が放電されて、積分回路 10_mの出力端より出力される電圧値が初期化される。一方、スイッチ SW が開いているときには、共通配線 50_mを経て入力端に入力した電荷が容量素子 C に蓄積され、この容量素子 C に蓄積されている電荷の量に応じた電圧値が出力端より出力される。

【0019】

図 3 は、本実施形態に係る光検出装置 1 に含まれるユニット U_mおよび制御回路 40 の構成図である。制御回路 40 は、光検出装置 1 の全体の動作を制御するものであり、光検出装置 1 において 1 つのみ設けられていればよい。具体的には、制御回路 40 は、各ユニット U_mに含まれる N 個のスイッチ SW_{m,1}～SW_{m,N}それぞれを順次に閉じて、N 個のフォトダイオード PD_{m,1}～PD_{m,N}それぞれを順次に積分回路 10_mの入力端に電氣的に接続させる。制御回路 40 は、積分回路 10_mに含まれるスイッチ SW の開閉を制御して、積分回路 10_mにおける初期化および積分動作のタイミングを制御する。また、制御回路 40 は、CDS 回路 20_mおよびホールド回路 30_mそれぞれの動作のタイミングをも制御する。

【0020】

また、図3に示されるように、本実施形態に係る光検出装置1は、第1基板100および第2基板200の2つの基板上に分割されている。すなわち、第1基板100上には、 $M \times N$ 個のフォトダイオード $PD_{1,1} \sim PD_{M,N}$ がM行N列に配列されている。また、第2基板200上には、 $M \times N$ 個のスイッチ $SW_{1,1} \sim SW_{M,N}$ 、M個の積分回路 $10_1 \sim 10_M$ 、M個のCDS回路 $20_1 \sim 20_M$ 、M個のホールド回路 $30_1 \sim 30_M$ および 1個の制御回路40 が配置されている。そして、第1基板100と第2基板200とが互いにバンプ接続されている。

【0021】

第1基板100に光が入射すると、各ユニット U_m において、閉じているスイッチ $SW_{m,n}$ に対応するフォトダイオード $PD_{m,n}$ から、そのフォトダイオード $PD_{m,n}$ への入射光の強度に応じた量の電荷が出力され、その電荷は、第1基板100からバンプ接続を経て第2基板200へ移動し、第2基板200上のスイッチ $SW_{m,n}$ および共通配線 50_m を経て積分回路 10_m の入力端に入力する。そして、第2基板200上の積分回路 10_m の出力端より、フォトダイオード $PD_{m,n}$ で発生した電荷の量に応じた電圧値が出力される。さらに、第2基板200上のCDS回路 20_m より、積分回路 10_m より出力された電圧値の一定時間の変動分を表す電圧値が出力され、第2基板200上のホールド回路 30_m により、CDS回路 20_m より出力された電圧値が一定期間に亘って保持され出力される。各ユニット U_m において、N個のスイッチ $SW_{m,1} \sim SW_{m,N}$ それぞれが順次に閉じて、N個のフォトダイオード $PD_{m,1} \sim PD_{m,N}$ それぞれから出力された電荷について同様の処理が順次になされる。

【0022】

次に、本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100と第2基板200との間の配置関係および電氣的接続について、図4～図7を用いて詳細に説明する。

【0023】

図4は、本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の配置関係を示す斜視図である。本実施形態に係る光検出装置1では、第1基板100と第2基板200とが互いにバンプ接続されていて、第1基板1

00上のフォトダイオード $PD_{m,n}$ と、第2基板200上のスイッチ $SW_{m,n}$ の第1端とが、互いに電氣的に接続されている。そして、この図に示されるように、それぞれの基板が光の入射方向に重なるように積層されて実装されている。また、この積層方向（各基板の面に対して垂直な方向）に見たときに、第2基板200の外枠は、第1基板100の外枠と一致するか、或いは、第1基板100の外枠より内側にあるのが好適である。このような第1基板100および第2基板200それぞれのサイズの関係は、第1基板100と第2基板200とをバンプ接続することにより可能である。そして、このようにすることにより、複数の光検出装置1を配列する際に、フォトダイオードが設けられている各々の第1基板100を極めて接近させて又は接触させて配列することができる。

【0024】

図5は、本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の断面の1例を示す図である。なお、この図において、左右方向に基本パターンが繰り返されて示されているので、以下では1つの基本パターンについてのみ説明する。

【0025】

第1基板100は、n型半導体基板の第1面（図で上側の面）上に、該n型基板とともにpn接合を形成してフォトダイオードPDを構成するp⁺領域111と、アイソレーション領域としてのn⁺領域112とが形成されている。また、第1基板100は、n型半導体基板の第2面（図で下側の面）上に、ボンディングパッド124とオーミック接続を形成するn⁺型不純物層121と、表面を保護するための絶縁性の保護層122と、保護層122を貫通してn⁺型不純物層121と電氣的に接続されるボンディングパッド124とが形成されている。さらに、第1基板100は、第1面と第2面との間を貫通する貫通孔が設けられ、その貫通孔に貫通電極131が設けられている。そして、第1基板100の第1面側においてp⁺領域111と貫通電極131とを電氣的に接続する金属配線113が絶縁膜114上に形成され、また、第2面側において貫通電極131と電氣的に接続されたボンディングパッド123が形成されている。

【0026】

第2基板200は、半導体基板の第1面（図で上側の面）上に、スイッチSWの第1端と電氣的に接続されたボンディングパッド223、及び、接地電位に電氣的に接続されたボンディングパッド224が形成されている。そして、第1基板100のボンディングパッド123と第2基板200のボンディングパッド223とはバンプ423により互いに接続されており、また、第1基板100のボンディングパッド124と第2基板200のボンディングパッド224とはバンプ424により互いに接続されている。第1基板100と第2基板200との間の間隙は樹脂により充填されている。

【0027】

また、第1基板100の第1面の側には、シンチレータ510および遮蔽材520が配置されている。シンチレータ510は、第1基板100のp⁺領域111の上方に設けられ、X線等のエネルギー線が入射することによりシンチレーション光を発生するものである。遮蔽版520は、第1基板100のn⁺領域112の上方に設けられ、X線等のエネルギー線の透過を阻止するとともに、シンチレータ510を固定するものである。

【0028】

この図5に示される構成では、X線等のエネルギー線がシンチレータ510に入射すると、そのシンチレータ510よりシンチレーション光が発生する。さらに、そのシンチレーション光が第1基板100のp⁺領域111に入射すると、pn接合部において電荷が発生する。その電荷は、金属配線113、貫通電極131、ボンディングパッド123、バンプ423および第2基板200のボンディングパッド223を経て、第2基板200上に形成されているスイッチSWを経て積分回路10の入力端に入力する。積分回路10のスイッチSWが開いていれば、入力端に入力した電荷は容量素子Cに蓄積される。そして、積分回路10の出力端より、容量素子Cに蓄積されている電荷の量に応じた電圧値が出力される。

【0029】

図6は、本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の断面の他の例を示す図である。なお、この図においても、左右方向に

基本パターンが繰り返されて示されているので、以下では1つの基本パターンについてのみ説明する。

【0030】

第1基板100は、n型半導体基板の第1面（図で上側の面）上に、電荷再結合を防止するためのn⁺型アキュムレーション層151と、表面を保護するための絶縁性の保護層152とが形成されている。第1基板100は、n型半導体基板の第2面（図で下側の面）上に、該n型基板とともにpn接合を形成してフォトダイオードPDを構成するp⁺領域161が形成され、アイソレーション領域としてのn⁺領域162が形成され、これらの上に保護層163が形成されている。また、第1基板100の第2面には、p⁺領域161と電氣的に接続されたボンディングパッド164と、n⁺領域162と電氣的に接続されたボンディングパッド165とが形成されている。

【0031】

第2基板200は、半導体基板の第1面（図で上側の面）上に、スイッチSWの第1端と電氣的に接続されたボンディングパッド264およびボンディングパッド265が形成されている。そして、第1基板100のボンディングパッド164と、第2基板200のボンディングパッド264とは、バンプ464により互いに接続されている。第1基板100のボンディングパッド165と、第2基板200のボンディングパッド265とは、バンプ465により互いに接続されている。第1基板100と第2基板200との間の間隙は樹脂により充填されている。

【0032】

また、第1基板100の第1面の側には、シンチレータ510および遮蔽材520が配置されている。シンチレータ510は、第1基板100のp⁺領域161の上方に設けられ、X線等のエネルギー線が入射することによりシンチレーション光を発生するものである。遮蔽版520は、第1基板100のn⁺領域162の上方に設けられ、X線等のエネルギー線の透過を阻止するとともに、シンチレータ510を固定するものである。また、第1基板100は、p⁺領域161が形成された部分において、第1面側が研削されて、厚みが薄くされている。

【0033】

この図6に示される構成では、X線等のエネルギー線がシンチレータ510に入射すると、そのシンチレータ510よりシンチレーション光が発生する。さらに、そのシンチレーション光が第1基板100を透過してp⁺領域161に入射すると、pn接合部において電荷が発生する。その電荷は、ボンディングパッド164、バンプ464および第2基板200のボンディングパッド264を経て、第2基板200上に形成されているスイッチSWを経て積分回路10の入力端に inputs。積分回路10のスイッチSWが開いていれば、入力端に inputsした電荷は容量素子Cに蓄積される。そして、積分回路10の出力端より、容量素子Cに蓄積されている電荷の量に応じた電圧値が出力される。

【0034】

図7は、本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の断面の更に他の1例を示す図である。この図に示された断面構造は、図5に示された断面構造と略同様であるが、第1基板100におけるフォトダイオードの配置のピッチより、第1基板100と第2基板200との間のバンプ接続におけるバンプ423の配置のピッチが短い点が相違している。また、このような構成とするために、第1基板100におけるフォトダイオードの配置のピッチより、第2基板200に形成されたボンディングパッド223の配置のピッチが狭くなっている。また、第1基板100の第2面側に形成されたボンディングパッド123は、貫通電極131との接続位置からバンプ423との接続位置まで、必要に応じて長くなっている。なお、この図では、ボンディングパッド124、ボンディングパッド224およびバンプ424が示されていないが、これらについても同様である。また、図6に示された断面構造においても、第1基板100におけるフォトダイオードの配置のピッチより、第1基板100と第2基板200との間のバンプ接続におけるバンプ464、465の配置のピッチが短くなっているもよい。

【0035】

次に、本実施形態に係る光検出装置1における第2基板200の断面構造について、図8および図9を用いて詳細に説明する。

【0036】

図8は、本実施形態に係る光検出装置1における第2基板200の階層構造の説明図である。同図(a)は、バンプ接続用のボンディングパッド290(図5および図7におけるボンディングパッド223, 224、図6におけるボンディングパッド264, 265)が設けられた層における、これらボンディングパッド290の配置を模式的に示す。同図(b)は、各ユニット U_m に含まれるN個のスイッチ $SW_{m,1} \sim SW_{m,N}$ 、積分回路10_m、CDS回路20_m、ホールド回路30_mおよび制御回路40それぞれの半導体層およびゲート層の形成領域の配置を模式的に示す。また、同図(a), (b)において、領域Fは、第2基板200の面に対して垂直に第2基板200を見たときに全てのボンディングパッド290を含む最小矩形領域を示す。

【0037】

この図に示されるように、第2基板200において、バンプ接続用のボンディングパッド290が設けられた層より下の層に、各ユニット U_m に含まれるN個のスイッチ $SW_{m,1} \sim SW_{m,N}$ 、共通配線50_m、積分回路10_m、CDS回路20_mおよびホールド回路30_mが形成されており、また、図示していないが、制御回路40も形成されているのが好適である。また、これらが領域F内に形成されているのが好適である。さらに、各ユニット U_m について、N個のフォトダイオードPD_{m,n}それぞれから積分回路10_mの入力端へ至るまでの電荷移動経路に沿った距離を $L_{m,n}$ としたとき、距離 $L_{m,1} \sim L_{m,N}$ のうちの最大距離が最小となる位置において、共通配線50_mに積分回路10_mの入力端が接続されているのが好適である。

【0038】

図9は、本実施形態に係る光検出装置1における第2基板200の断面図である。この図に模式的に示されるように、第2基板200には、下(基板側)から上へ向かって順に、半導体層270、ゲート層281、絶縁層282、第1金属配線層283、絶縁層284、第2金属配線層285、絶縁層286およびボンディングパッド290が設けられている。

【0039】

半導体層 270 は、n 型半導体基板に n+ 型領域 271 が形成され、この n+ 型領域 271 内に p+ 型領域 272 および p+ 型領域 273 が形成されている。半導体層 270 およびゲート層 281 は、各種の回路（積分回路 10_m、CDS 回路 20_m、ホールド回路 30_m、制御回路 40）を構成するものである。第 1 金属配線層 283 は、回路間または回路内の信号配線として用いられる。第 2 金属配線層 285 は、回路に電源電圧を供給するための配線として用いられる。第 1 金属配線層 283 および第 2 金属配線層 285 それぞれは、所定の箇所において、コンタクトホールを介して、半導体層 270 またはゲート層 281 と電氣的に接続されている。また、ボンディングパッド 290 は、所定の箇所において、コンタクトホールを介して、第 1 金属配線層 283 と電氣的に接続されている。

【0040】

このように、本実施形態に係る光検出装置 1 では、バンプ接続用のボンディングパッド 290 が設けられた層より下の層に、各ユニット U_m に含まれる N 個のスイッチ SW_{m,1} ~ SW_{m,N}、共通配線 50_m、積分回路 10_m、CDS 回路 20_m、ホールド回路 30_m および制御回路 40 も形成されている。

【0041】

このように構成される本実施形態に係る光検出装置 1 では、第 2 基板 200 の小型化が容易になるとともに、各フォトダイオード PD_{m,n} から積分回路 10_m の入力端へ至るまでの電荷移動経路が短くなって、その経路上の配線における寄生容量が小さくなり、それ故、積分回路 10_m から出力される電圧値に含まれる雑音が小さく、正確な光検出をすることが可能となる。

【0042】

以上のように構成される本実施形態に係る光検出装置 1 は、以下のような効果を奏することができる。すなわち、各フォトダイオード PD_{m,n} から積分回路 10_m の入力端へ至るまでの電荷移動経路が短くなって、その経路上の配線における寄生容量が小さくなり、それ故、積分回路 10_m から出力される電圧値に含まれる雑音が小さく、正確な光検出をすることが可能となる。また、第 1 基板 100 上には積分回路 10_m などの信号処理の為の回路が設けられていないので、画素数の増加や高密度化が可能である。また、第 1 基板 100 より第 2 基板 200

を小さくすることが容易となり、複数の光検出装置 1 を配列する際に、フォトダイオードが設けられている各々の第 1 基板 100 を極めて接近させて又は接触させて配列することができる。また、フォトダイオードアレイが形成される第 1 基板 100 と、積分回路 10_m などの信号処理回路が形成される第 2 基板 200 とで、最適な製造プロセスを採用することができるので、この点でも好ましい。

【0043】

さらに、従来の技術の欄で挙げた特許文献 1 に開示された発明と比較すると、本実施形態に係る光検出装置 1 は下記のような利点をも有する。すなわち、特許文献 1 に開示された発明では、第 1 基板と第 2 基板とがワイヤボンディングで接続されることから、第 1 基板上にシンチレータを配列する際に、ワイヤボンディングの為のパッドの上方には、シンチレータを配置することができず、或いは、シンチレータを配置したとしても該シンチレータの形状を他とは異なるものとしなければならない。このことから、特許文献 1 に開示された発明では、複数の光検出素子を並列配置したときに各々の第 1 基板上の複数のフォトダイオードは一樣なピッチでは配列され得ず、或いは、1 つの光検出素子においても第 1 基板上の複数のフォトダイオードは一樣な感度では光を検出し得ない。これに対して、本実施形態に係る光検出装置 1 では、第 1 基板と第 2 基板とがバンプ接続されていて、第 1 基板より第 2 基板を小さくすることができるので、このような問題が生じない。

【0044】

本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、第 1 基板 100 および第 2 基板 200 それぞれの断面構造は、図 5 ～ 図 7 および図 9 それぞれに示されたものに限定されない。また、第 2 基板 200 上には、更に他の回路（例えば、ホールド回路 30_m からの出力電圧値を A/D 変換する A/D 変換回路など）が設けられていてもよい。

【0045】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したとおり、本発明に係る光検出装置では、フォトダイオードが設けられた第 1 基板と、共通配線および積分回路などが設けられた第 2 基板

とは、互いにバンプ接続されている。さらに、第2基板において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、共通配線および積分回路などが設けられている。このような構成としたことにより、本発明に係る光検出装置では、各フォトダイオードから積分回路の入力端へ至るまでの電荷移動経路が短くなって、その経路上の配線における寄生容量が小さくなり、それ故、積分回路から出力される電圧値に含まれる雑音が小さく、正確な光検出をすることが可能となる。また、第1基板上には積分回路などの信号処理の為の回路が設けられていないので、画素数の増加や高密度化が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施形態に係る光検出装置1の構成図である。

【図2】

本実施形態に係る光検出装置1に含まれる積分回路10_mの回路図である。

【図3】

本実施形態に係る光検出装置1に含まれるユニットU_mおよび制御回路40の構成図である。

【図4】

本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の配置関係を示す斜視図である。

【図5】

本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の断面の1例を示す図である。

【図6】

本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の断面の他の例を示す図である。

【図7】

本実施形態に係る光検出装置1における第1基板100および第2基板200の断面の更に他の1例を示す図である。

【図8】

本実施形態に係る光検出装置 1 における第 2 基板 200 の階層構造の説明図である。

【図 9】

本実施形態に係る光検出装置 1 における第 2 基板 200 の断面図である。

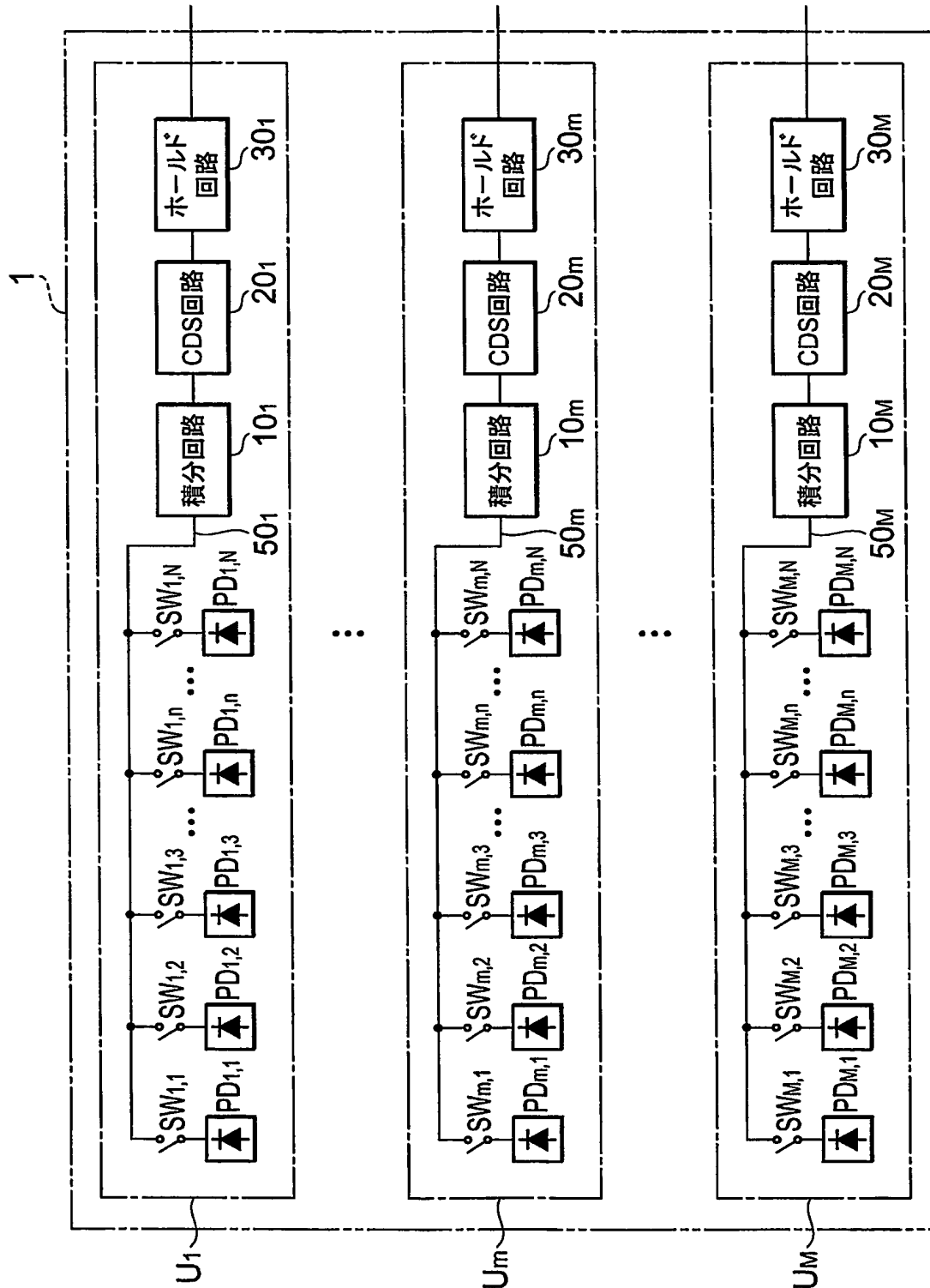
【符号の説明】

1…光検出装置、10…積分回路、20…CDS回路、30…ホールド回路、
40…制御回路、50…共通配線、100…第1基板、200…第2基板、A…
アンプ、C…容量素子、PD…フォトダイオード、SW…スイッチ。

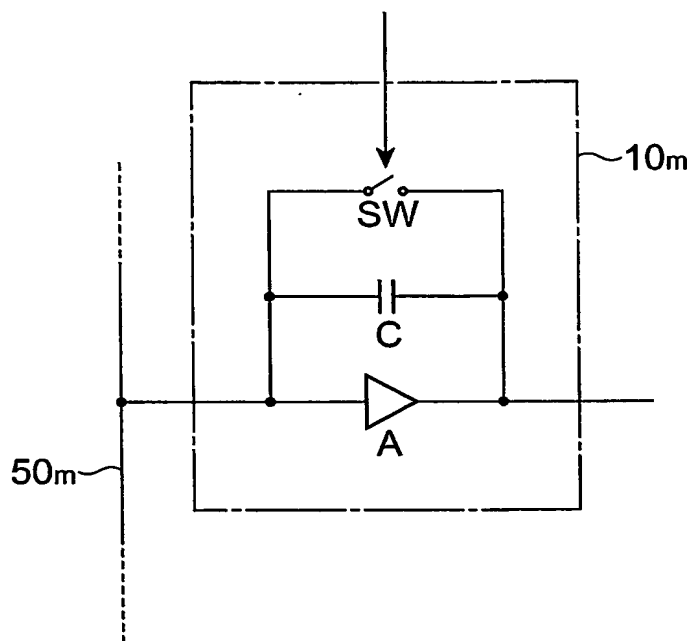
【書類名】

図面

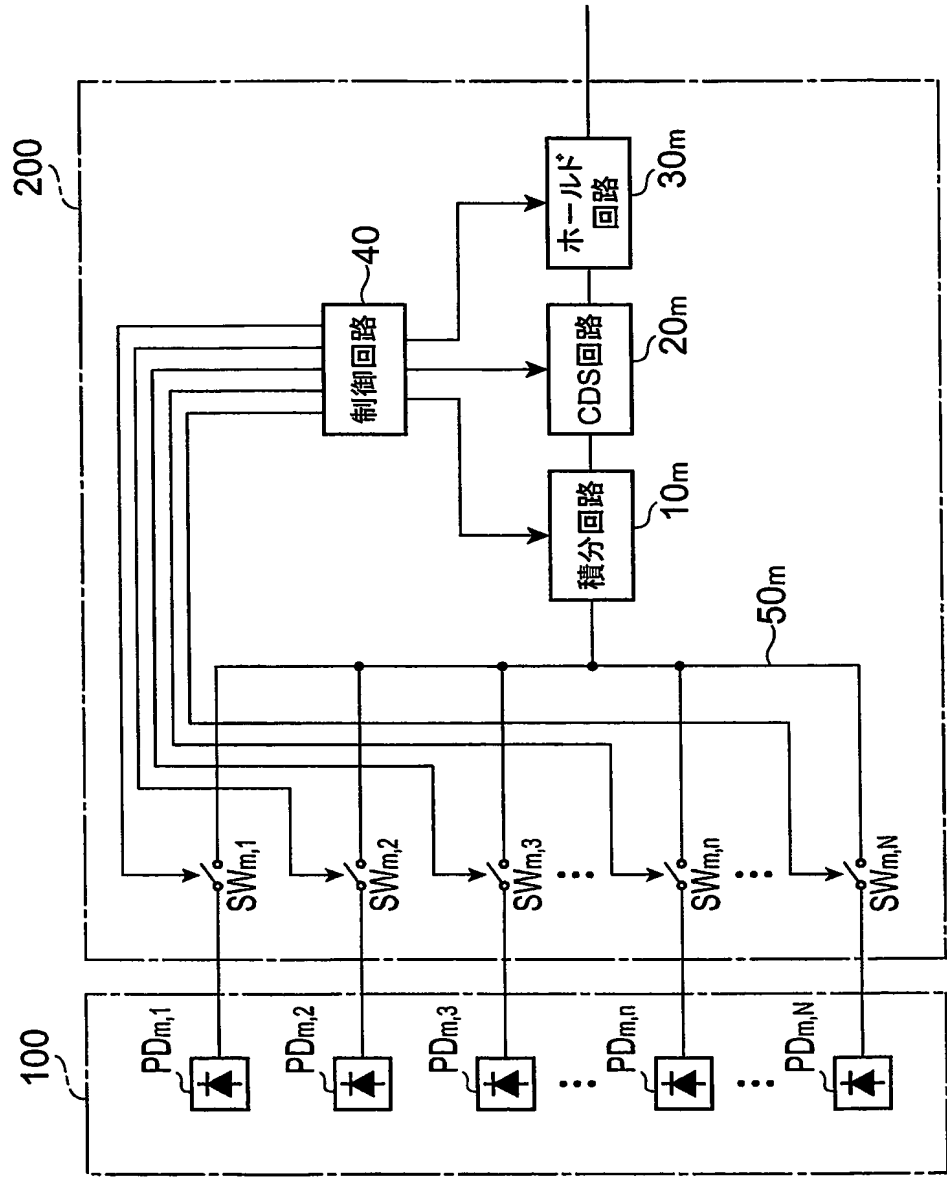
【図 1】



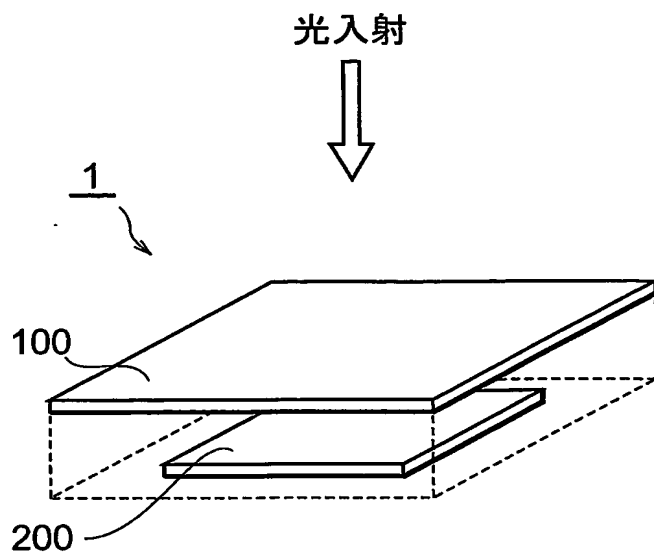
【図 2】



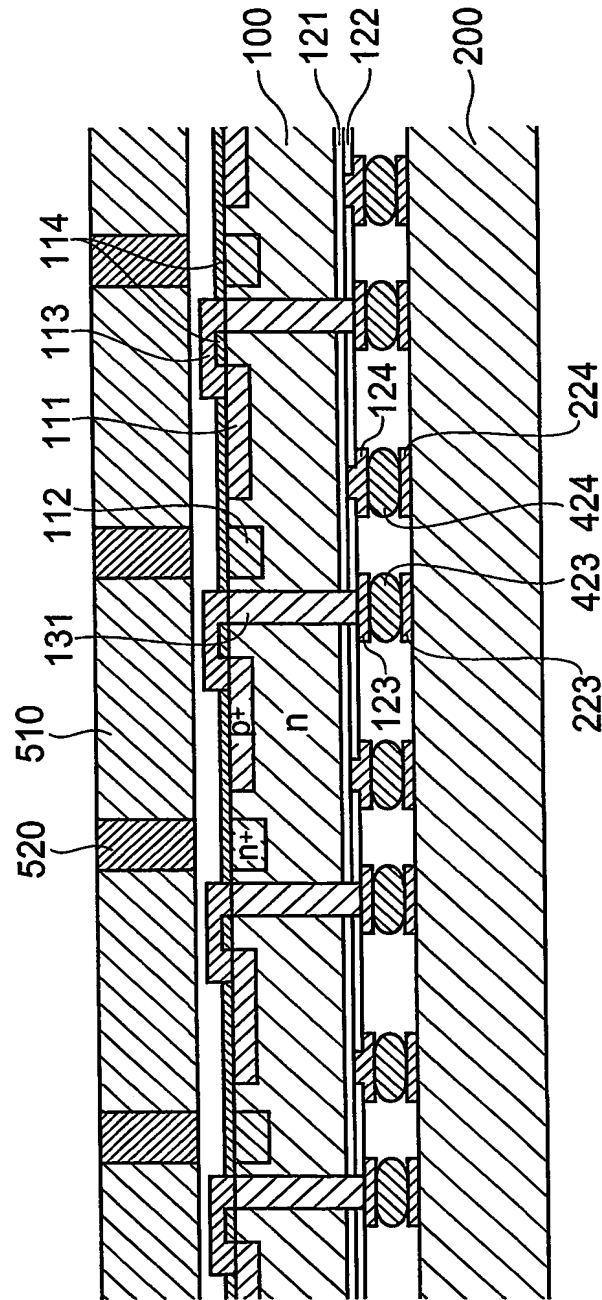
【図 3】



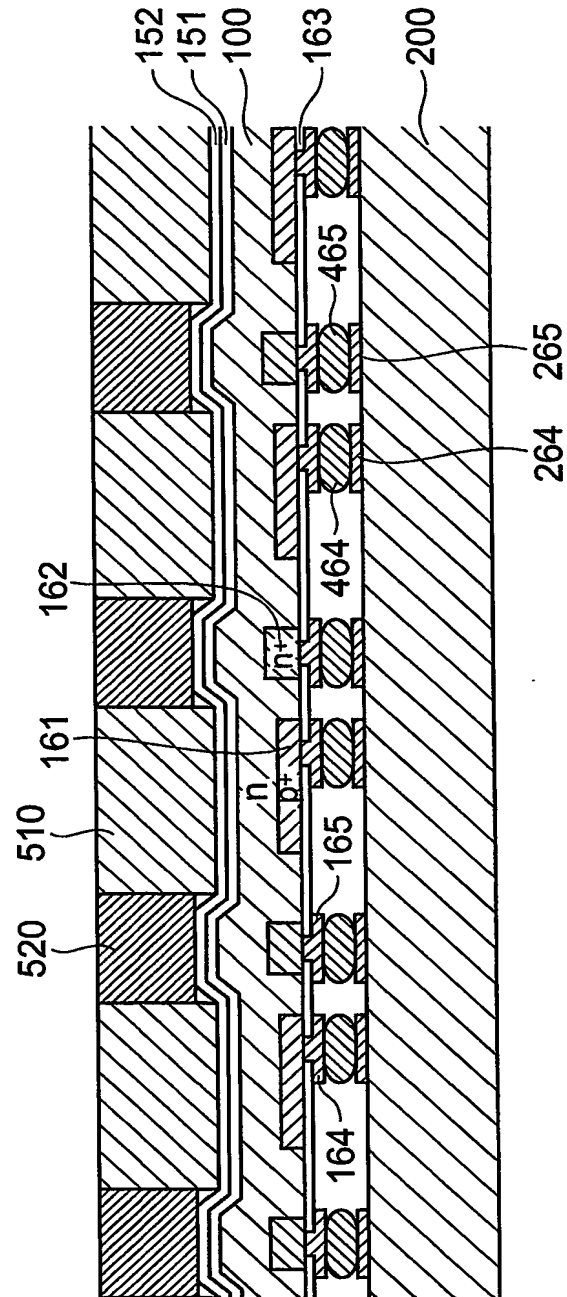
【図 4】



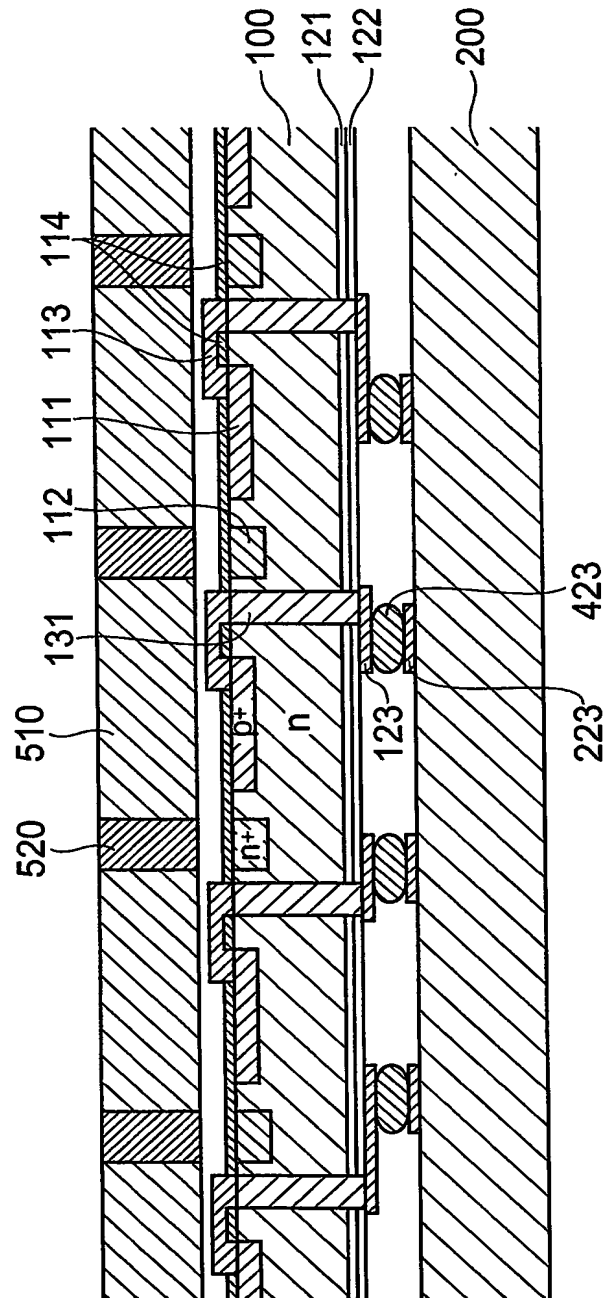
【図 5】



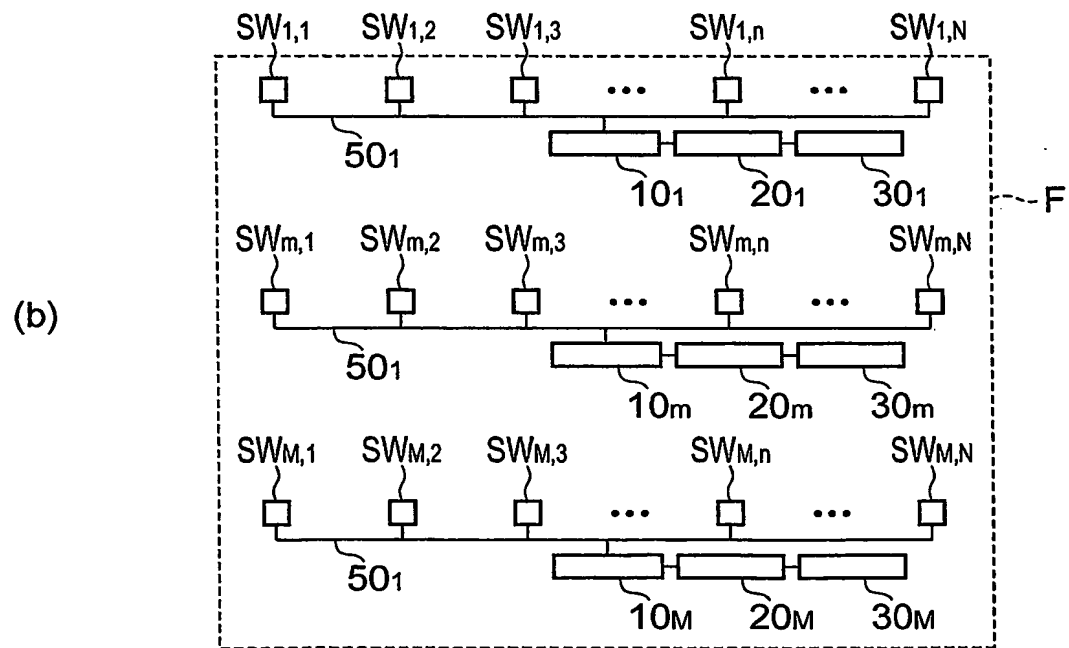
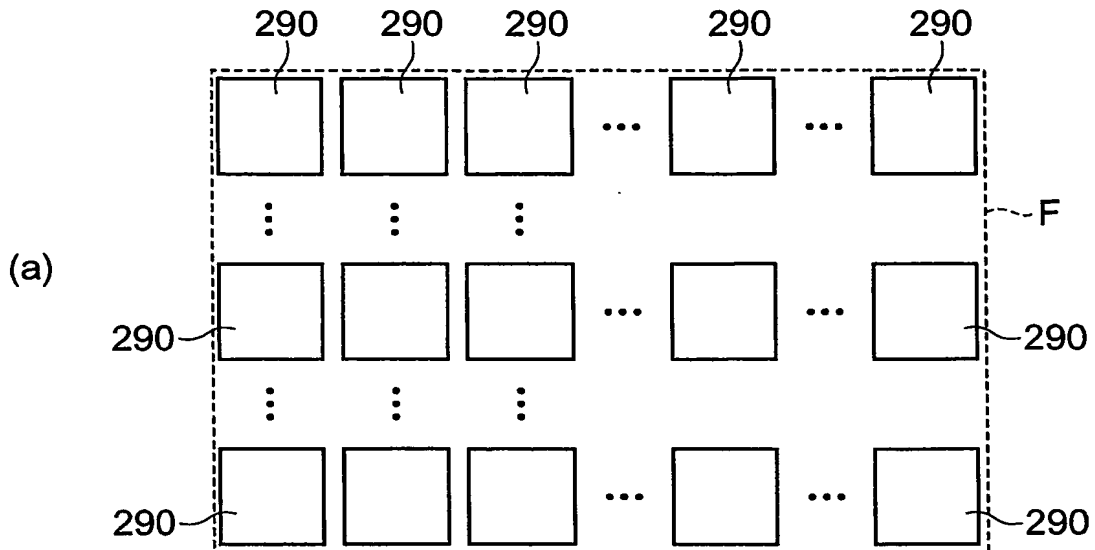
【図 6】



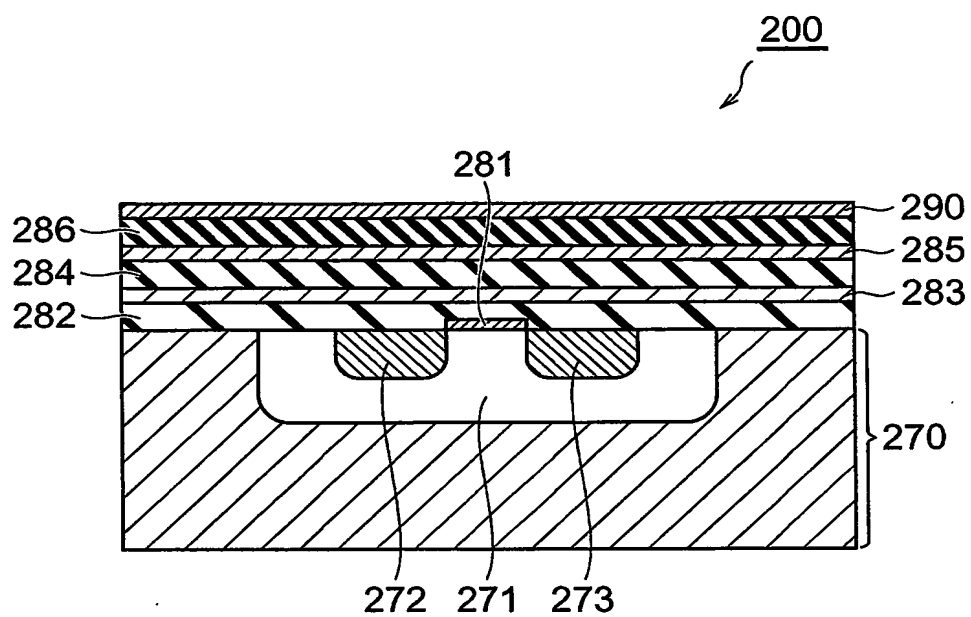
【図 7】



【図 8】



【図 9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画素数の増加や高密度化が可能であって正確な光検出をすることができる光検出装置を提供する。

【解決手段】 閉じているスイッチ $SW_{m,n}$ に対応するフォトダイオード $PD_{m,n}$ から、そのフォトダイオード $PD_{m,n}$ への入射光の強度に応じた量の電荷が出力され、その電荷は、第1基板100からバンプ接続を経て第2基板200へ移動し、第2基板200上のスイッチ $SW_{m,n}$ および共通配線 50_m を経て積分回路 10_m の入力端に入力する。そして、第2基板200上の積分回路 10_m の出力端より、フォトダイオード $PD_{m,n}$ で発生した電荷の量に応じた電圧値が出力される。第2基板200において、バンプ接続用のボンディングパッドが設けられた層より下の層に、スイッチ $SW_{m,1} \sim SW_{m,N}$ 、共通配線 50_m および積分回路 10_m などが形成されている。

【選択図】 図3

特願 2 0 0 2 - 3 3 4 0 7 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 3 6 4 3 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 1 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地の 1

氏 名

浜松ホトニクス株式会社